

## SCIENCE ENGINEER

🔄 13 березня 2023 📍 Місто: [Київ](#)

📍 Готовий до відряджень: [Львів](#), [Чернівці](#), [Івано-Франківськ](#)

Вік: 36 років

Режим роботи: повний робочий день, вільний графік роботи, позмінна робота

Категорії: IT, WEB фахівці, Наука, освіта, переклади, Виробництво

✓ Готовий до відряджень

### Досвід роботи

#### Experimental setup operator role

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Science), Київ

05.2018 – 08.2021 (3 роки 3 місяці)

##### Обов'язки:

Experiment design role at laboratory of Institute of high technologies at the department of Nano physics condensed matter.

Adjusting, hardware and software implementing, service providing of experimental setup.

and providing.

Precision hand work up to 50 mkm resolution of positioning in combine with software programming such as Labview for instance. Measurements of samples at wide temperature range.

Performance at thematic scientific conferences.

Several articles at stock.

✓ Є рекомендації з даного місця роботи

#### Head of engineering team

Service of Apple devices (Electronic devices repairing company), Київ

12.2012 – 08.2020 (7 років 8 місяців)

##### Обов'язки:

Troubleshooting and repair damaged motherboards of MacBooks, iPads, iPods and iPhones.

Soldering of 01005/008004 SMD components and BGA chips mont technology at various cases, such as under upgrade, modification or repair procedures.

Executive cellular phones Vertu repairing and servicing.

Experimental and custom projects team lead.

Prototyping and producing of miniaturized custom electronics.

Employing and training new stuff.

### Освіта

#### Taras Shevchenko National University of Kyiv (Київ)

Спеціальність: Radio physics Faculty, Department of Electro physics, specialization applied optics and magnetism

повна вища, 09.2006 – 05.2012 (5 років 7 місяців)

## Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Fast learning curve and strong adaptability. Scrupulous with attention to details. Strong interest to miniaturized electronic schematics at limited space of packaging and installing.